

公司简介 Company Profile

专注于声学科研和商业化

深圳市九音科技有限公司("九音科技")是一家专注于声学科研和商业化的高新技术企业。公司成立于2017年,我们的愿景是成为音频领域中特色技术解决方案的提供商。

公司的主要产品包括集成AI算法、高质量编解码器、高性能DSP、高速USB与电源管理单元的专业音频处理器系列,支持客户深度定制开发和算法+芯片+应用设计的turn-key解决方案。

九音科技和行业顶尖的IP合作伙伴与芯片生产企业合作,打造出世界一流的音频处理器与配套元器件,为客户提供质量可靠、供应稳定与服务专业的声学解决方案。



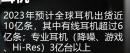


















有交互和控制需求的终端都将具备音频入口,对音质和个性化感知的要求不断提升

company confidential

量为2760万辆,同比增长3%

目录

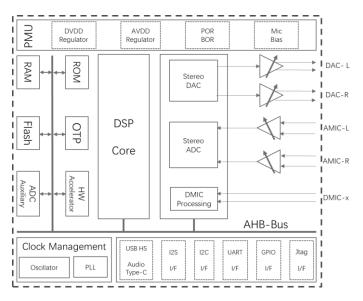


- SNC8x系列 32Bit 高性能音频信号处理器
- HiFi3 内核简介
- 合作生态
- SDK开发平台
- 模组信息
- 芯片信息
- 丰富的开发者生态
- 更多资料

SNC8系列 32Bit 高性能音频信号处理器



- SNC8x系列音频信号处理器,集成AI算法和高质量编解码器、高性能DSP、高速USB与电源管理单元。
- 单芯片高集成度, 大幅降低了产品的BOM成本和开发周期。
- 丰富的开发者生态



关键技术指标

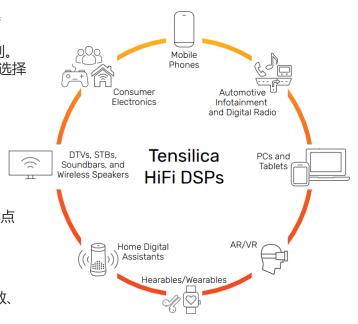
- Cadence Tensilica 32位 HiFi3 DSP核心 @200MHz
- 32位浮点计算单元、AI硬件加速
- 内建AGC、DRC、混音器、风噪抑制
- · 内建LDO与DC-DC电源管理单元
- 24位高精度ADC, SNR>=106dB, 采样率高达192kHz
- 24位高精度DAC, SNR>=101dB, 采样率高达192kHz
- 支持USB2.0高速控制器与PHY, 完整支持UAC 1.0/2.0
- 支持3路全双工I2S输入/输出,采样率高达192kHz
- 支持2路模拟/10路数字麦克风
- 支持1路全双工UART与JTAG
- 支持12位 SAR ADC
- 支持2路I²C



HiFi3 内核简介



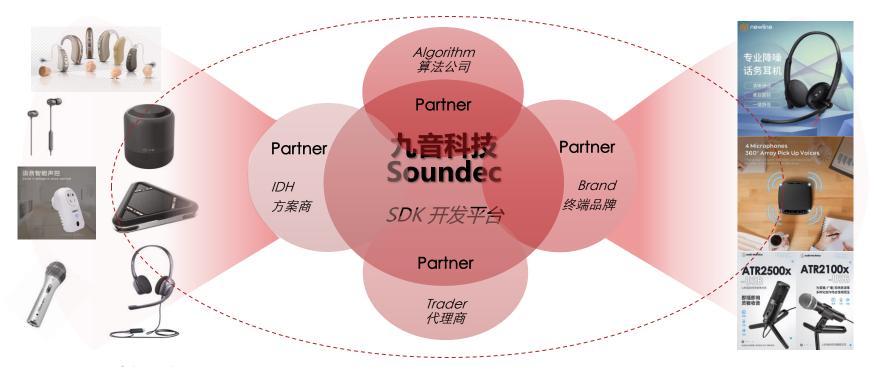
- Tensilica HiFi DSP 的市场应用现状
 - Tensilica HiFi DSP系列是许可数量最多的音频/声音/语音处理器
 - 支持超过300款认证软件包
 - 已有125家以上软件合作伙伴参与Tensilica Xtensions™伙伴计划。
 - 100多家顶级半导体公司和系统OEM为其音频、声音和语音产品选择了 Tensilica HiFi DSP
- · HiFi3 架构
 - HiFi3是一种VLIW架构,支持三个Slot并行执行。
 - 支持两个乘加器,四个乘法器
 - 良好的支持32x16位和32x32位乘法
 - 支持真正的64位数据路径和ITU-T/ETSI标准
 - 一个可选的浮点单元,提供2路SIMD,每个周期支持单精度IEEE浮点 MAC或ALU操作
- HiFi3 DSP运算库
 - 支持通用DSP库,该库包含FIR滤波器、IIR滤波器、基本数学函数、 Matrix矩阵操作,以及FFT运算



合作生态



依托SNC86x系列的SDK开放平台,与更多优秀的合作方一起打开产品市场



SDK开发平台



Software Develop Kit



USB Connection



通过USB线连接评估板和PC, 辅助调试EVA及代码升级

EVA Board



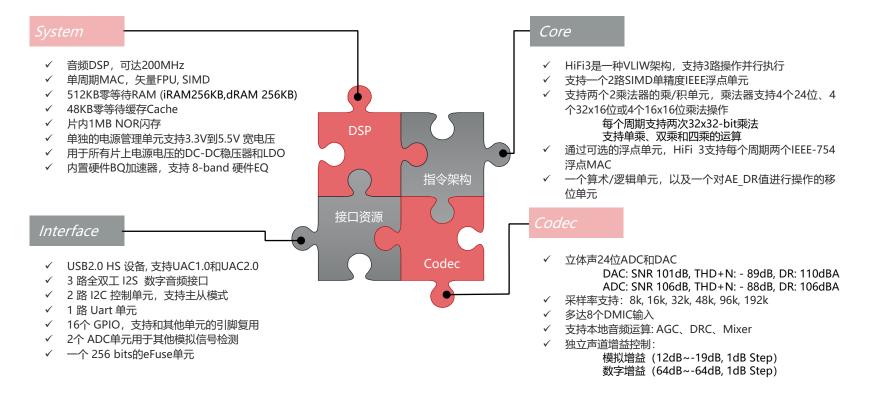
- 功能完整的EVA评估板, 用于在线调试、评估音 效
- 支持3.5mm、USB Type-C等丰富的音频与 调试接口,1小时搭建典 型应用
- · 通过Adapter Socket, 支持适配不同的模块, 快速扩展应用方案

测试主题:系统效率工作主频:220MHz测试SDK版本:SDK20 V1.0

| USB模式下,采样精度为24Bit

音频通路 (SDK可用dRAM空间>=217KB) 采样率 ADC->DAC I2S->DAC 12S->12S ADC->I2S USB->DAC ADC->USB 可用算力资源 可用算力资源 可用算力资源 可用算力资源 可用算力资源 可用算力资源 48K@32bit 94.79% 94.75% 94.1% 94.3% 95.17% 94.36% 96K@32bit 90.59% 90.08% 89.2% 89.6% 93,35% 91.87% 192K@32bit 82.52% 81,38% 79.25% 80.21% 89,59% 85.97%

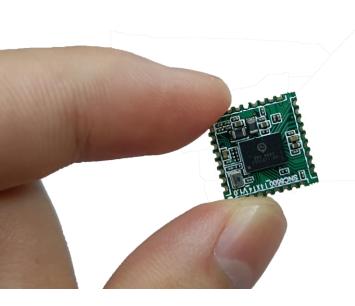
SNC8x主要资源参数



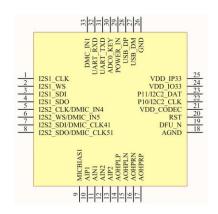
模组信息 — BMT02

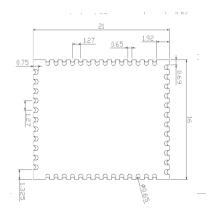


BMT02-14x14



- BMT02是一款支持最多4路PDM数字麦克风输入的语音前端解决方案模组。
- 同时支持1组立体声模拟差分输入、1组立体声模拟差分输出、1组全双工I2S、1路I2C、1路Uart、1路USB。
- 主要适用场景:
 - 车载前端、会议通话、IoT、USB麦克风
- 邮票孔尺寸: 14x14 (mm) , 孔径: 0.65mm。

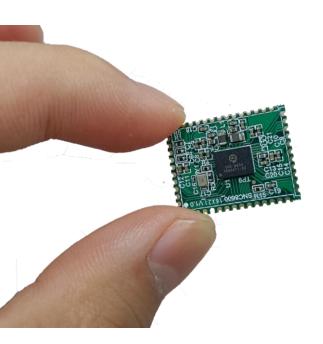




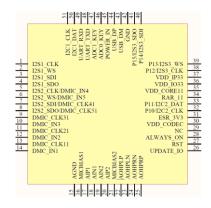
模组信息 — BMT03

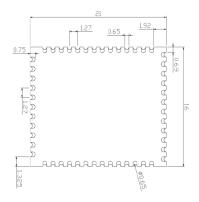






- BMT03是一款支持最多6路PDM数字麦克风输入的语音前端解决方案模组。
- 同时支持1组立体声模拟差分输入、1组立体声模拟差分输出、3组全双工I2S、2路I2C、1路Uart、1路USB。
- 主要适用场景:
 - 会议通话、车载前端、 IoT、USB麦克风
- 邮票孔尺寸: 26x21 (mm) , 孔径: 0.65mm。

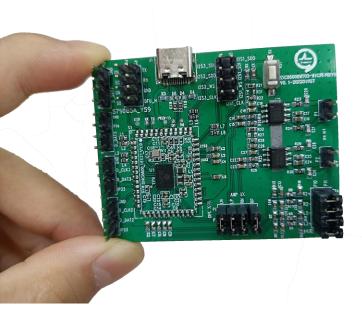




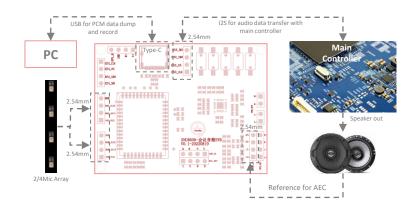
模组信息 — BMT03 麦克风阵列







- BMT03-麦克风阵列EVB,是一款专门支持麦克风阵列处理的前端语音信号采集模组。
- 本模组支持模拟输入、模拟输出、4路数字PDM麦克风输入,2组全双工I2S输出、1路USB UAC1.0、UAC2.0。
- 结合语音算法可以实现如下功能:
 - 远场拾音、声源定位、语音唤醒、语音增强、回声消除、通话降噪等
- 主要适用场景:
 - · 智能家居、车载前端、会议通话、IoT



芯片信息

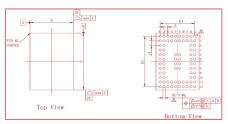


封装信息

SNC8600: BGA80

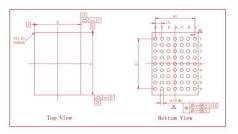
E: 6.2mm; D: 4.5mm; e: 0.4mm; e1: 0.5mm





SNC8600A: BGA63 E: 3.5mm; D: 4.5mm; e: 0.5mm; e1: 0.5mm





主要参数			
芯片定位	Audio CODEC SOC including USB		
工艺制程	TSMC 40nm uLP		
内核	Cadence HiFi3 up to 200MHz		
RAM	512KB(iRAM 256KB, dRAM 256KB)		
Flash	1MB		
麦克风	模拟麦克风:2个 (SNC8600/8600A) 数字麦克风:10个(SNC8600);8个(SNC8600A)		
接口	I2C	SNC8600: 2个; SNC8600A: 1个	
	I2S	SNC8600: 3个; SNC8600A: 2个	
	USB2.0 HS/FS	1个	
	UART	1个	
	ADC	SNC8600: 2个; SNC8600A: 1个	
XTAL	24MHz 12pF 10ppm ESR < 100Ω		
采样率	最高24bit/192K		
ADC input Path (24bit,48KHz)	SNR		106dB
	Dynamic range		106dB
	THD+N		-88dB
DAC output Path (32Ω 24bit,48KHz GOM/GOD=0dB)	Output Power		30mW
	SNR		101dB
	Dynamic range		110dB
	THD+N		-81dB
	Noise level		< 5uVrms

丰富的开发者生态

支持全文搜索的产品手册和评估板指南

丰富代码案例的开发手册, 快速上手

Soundec Studio™调试工具,实时调参与功能验证

在线工单系统, 8小时响应, 24小时提供解决方案

更多内容,请访问 https://dev.soundec.com

